

公司代码：688383

公司简称：新益昌

# HOSON 新益昌

深圳新益昌科技股份有限公司

2023 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2 重大风险提示

报告期内，公司实现营业收入 104,016.95 万元，较上年同期减少 12.12%；归属于上市公司所有者的净利润 6,030.38 万元，较上年同期减少 70.55%；归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,796.08 万元，较上年同期减少 74.15%。

2023 年，受宏观经济不确定性增强及行业周期下行等因素影响，下游产业需求收缩，公司经营面临多重挑战，公司管理层积极采取措施进行应对，营收同比有所下降，但整体经营规模仍维持在较高水平，行业地位和市场占有率未出现重大不利变化。

公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2024年4月26日，公司总股本102,133,600股，扣减回购专用证券账户中股份总数为644,096股，以此计算合计拟派发现金红利20,297,900.80元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，

纳入该年度现金分红的相关比例计算”，2023年度，公司通过集中竞价方式回购股份金额为15,772,818.59元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。综上，公司本年度现金分红金额共计36,070,719.39元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为59.81%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

#### 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	新益昌	688383	无

#### 公司存托凭证简况

适用 不适用

#### 联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	刘小环	袁茉莉
办公地址	深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园C8栋3楼	深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园C8栋3楼
电话	0755-27085880	0755-27085880
电子信箱	hoson@szhech.com	hoson@szhech.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

#### 1. 主要业务

公司主要从事半导体、LED、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售，为客

户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。经过多年的发展和积累，公司已经成为国内 LED 固晶机和电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业，积累了丰富的优质客户资源并打造了良好的品牌形象，成为国内外众多知名企业的合作伙伴，同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力，在半导体及 LED 领域进一步开拓市场，在锂电池设备领域蓄势待发，寻求差异化突破。此外，公司部分智能制造装备产品核心零部件如驱动器、高精度 DDR 电机、直线电机、音圈电机、大推力比直线电机、运动控制卡及高性能一体式控制器等已经实现自研自产，是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产能力的智能制造装备企业。

公司未来将继续聚焦国产智能制造装备的研发生产，顺应我国以智能制造装备产业为国家级战略性新兴产业发展的历史机遇，不断填补国内高端智能制造装备领域空白，提高我国高科技产业的国产化水平。


## 2.主要产品

设备类别	主要产品	产品简称	产品图示	产品特点及优势
半导体设备	全自动平面贴片固晶机（HAD812 系列）	半导体固晶机		适用于半导体封装，采用双点胶、全自动叠料兼容料盒进出技术，配备高速高精度邦头，稳定提升固晶效率，产能（UPH）18K/H，精度±20um，θ：±1°。
	连线机（HAD220/812/816-DDCO）	全自动固晶跳片烧结一体成型机		适用于功率器件封装，实现了产品从框架裸片进料、点胶、固晶、固跳线、回流焊接一系列工艺的自动化操作，有效提升产品良率及一致性，降低人工成本并提高生产效益。
	双摆臂固晶机（HAD818 系列）	半导体固晶机		适用于半导体封装，采用三点胶头、双摆臂结构、四夹爪、直线点胶的固晶平台，从而节省进出料时间，在保证固晶精度的同时又能提升产能（UPH）、降低人工成本。产能（UPH）28K/H，精度±20um，平台水平度可以达到 20um，满足胶点厚度的需求。

	料片式共晶机 (HAD810RP-PLUS)	邦头式料片热机		适用于 IC 行业，引线框架大多采用片料，有可控温区加热轨道平台，可进行一次固晶和两次固晶，采用高精度直线驱动固晶邦头，音圈扭力环精确控制固晶压力，伺服电机驱动晶框芯片角度矫正系统，配备自动扩膜系统，产能 (UPH) 18K/H，精度±25um。
	料卷式摆臂共晶机 (HAD810-RJ)	全自动固晶机		适用于 IC 行业，有单温区加热轨道平台，可进行一次固晶和两次固晶，能满足传统设备无法达到的 IC 行业料卷材料加热要求。采用卷料方式上料及裁切方式出料，高速双摆臂固晶结构，产能 (UPH) 25K/H，精度±25um。
	全自动多维引线焊线机 (K940-P)	翻转焊线机		适用于半导体激光二极管封装，在光通讯领域（如 2.5G、10G、25G 光模块元器件）和激光显示领域应用广泛。采用直线电机驱动的 XY 工作台；成熟稳定的摆动式音圈焊头及其运动控制系统；焊头分辨率高达 72nm；支持自动变焦的视觉系统；支持同轴与侧面照明的两种 LED 照明光源；具有灰度与形状两种模式精确识别的图像多元化识别系统。

	<p>粗铝丝压焊机 (K530)</p>	<p>铝线机</p>		<p>适用于半导体功率器件引线键合(如 TO-220、TO-263、TO-252、TO-247、TO-3P 等功率半导体器件), 兼容单排、双排产品, 可根据产品需求定制 4 排夹具。采用全光栅位置反馈, 定位精度可达 0.5um; 线性直驱电机调节 XYZ 三轴和压力, 精度高、速度快、耐磨损, 长期使用后不会产生机械间隙, 可极大延长设备使用寿命; 特有的焊接质量监控系统, 可对焊接过程中铝丝形变、超声功率、阻抗、电压电流、相位等参数进行实时跟踪, 并采用模板匹配法对焊接质量进行实时判断, 确保焊接品质稳定可靠。</p>
	<p>全自动平面焊线机 (KAW908)</p>	<p>平面焊线机</p>		<p>适用于半导体、LED 等器件的引线键合。可平稳控制焊头实现 150G 的高加速度运动并进行高速搜索与焊接压力的无缝切换; 实现邦头高速运动和极低振动的和谐统一; 实现对超声电流、电压、相位、阻抗全闭环数字控制, 并对超声焊接质量进行实时在线监控; 此外还有自主研发的高压负电子打火烧球系统及高速视觉识别系统等。</p>
	<p>转塔式半导体测试分选机 (XYC2220S-SOT23-GZXPCS)</p>	<p>转塔式半导体测试分选机</p>		<p>适用于 IC 芯片电阻、电容、电感、二极管、三极管轻触开关等各类贴片器件, 可实现电参数特性测试、六面外观视觉检测、激光镭射打标等功能。采用转塔式结构, 结合灵活的供料方式(振动盘、料管、Tray 盘或定制), 可实现不良品自动排出, 良品按一定的极性方向自动编带, 产能(UPH) 50K/H, 精度±10um, 稳定性(MTBA)≥2hr, 检测精度 0.05mm*0.05mm。</p>

LED 设备	六头平面式高速固晶机 (HAD8606 系列)	Mini LED 固晶机		采用三组同步固晶单元, 配置业内首创飞拍及二次修正技术, 可实现单台设备同时完成 RGB 固晶, 以及串联多台设备进行整线混 BIN 作业, 固晶精度 $\pm 15\mu\text{m}$ , $\theta \leq 2^\circ$ , 产能 (UPH) 180K/H, 良率 99.999%。
	双邦四臂 Mini LED 高速高精度固晶机 (HAD8630P 系列)	Mini LED 固晶机		采用业内领先的双邦四臂的直驱邦头结构, 配合线性电机驱动 XY(Wafer 平台) 和 BC(PCB 进料平台), 及业内首创底部飞拍和二次修正技术, 实现高速高精度 Mini LED 背光面板的固晶, 产能 (UPH) 40K/H, 固晶精度 $\pm 15\mu\text{m}$ , $\theta \leq 2^\circ$ , 良率 99.999%。
	平面式双头高速固晶机 (GT100 系列)	双头固晶机		全自动化双结构模式同步作业, 具有双固晶、双点胶、双吸晶平台结构和自动上下料功能, 产能 (UPH) 95K/H, 精度 $\pm 25\mu\text{m}$ 。
电容器设备	全自动智能牛角老化测试分选机 (HATC 系列)	牛角老化测试机		适用牛角和焊片型, 直径 22-35mm, 高度 25-80mm 的产品, 采用自动升压、全程静态、实时监控技术, 记录产品在老化充电过程中变化曲线, 具有 NG 品自动剔除功能。设备以气源加机械化设计, 使设备运行更为稳定, 简洁的中文操作界面和强大的工控操作控制系统, 使数据的采集、分析更为简便, 提升生产效率。

	全自动超级电容老化测试分选机（YCC 系列）	超电老化测试机		适用于引线型超级电容器的充电老化与分选，包含裸品或套管完成品的自动上料高温充电老化和高温放置，完成容量/自放电/直流电阻/交流内阻/电压分选工艺，达到高速充电老化和分选产品的目的；有效降低人工成本，缩短生产周期，大幅提高生产效率。
锂电池设备	全自动圆柱锂电池制片卷绕一体机（DC1860Y 系列）	制片卷绕一体机		实现制片、卷绕、正极耳合焊及自动下料装盘多工序集成，适用于 18650、21700、32650 和电子烟的圆柱锂电池。

## （二）主要经营模式

公司的盈利模式、研发模式、采购模式、生产模式、销售模式如下：

### 1. 盈利模式

公司主要从事半导体、LED、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售，从上游供应商采购原材料，针对客户相对个性化的需求，通过公司专业化研发和生产，向下游半导体、LED、电容器、锂电池等领域企业销售智能制造装备产品获得收入和利润。

### 2. 研发模式

公司自成立以来，为打破国外垄断、填补国内空白，始终坚持自主研发、自主创新的研发模式。公司始终致力于探索、改进智能制造装备的工艺制造流程，提高生产制造效率，提升产品良率。一方面，公司通过深入了解下游行业发展趋势，积极响应客户的实际应用场景需求，及时进行针对性的新项目研发，保证公司持续创新能力和行业先进性；另一方面，公司和众多知名企业客户展开深度合作，从长期客户服务中多角度收集客户关于产品的反馈信息，不断进行实际应用技术更新迭代。此外，公司一直在投入大量人力物力从生产技术突破、制造工艺升级及核心零部件自研自产等多维度提升智能制造装备产品性能，为客户提供行业领先的国产设备。

### 3. 采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式，根据生产计划安排采购，具体采购流程及供应商管理如下：

#### （1）采购流程

公司生产需要的零部件分为标准件和非标准件。标准件由采购部向供应商直接采购，如电子元件、传动部件和气动元件等；非标准件为生产所需的专用定制件，供应商依据公司提供的技术图纸和其他要求进行生产，如钣金件、机加件、齿轮等。

公司 PMC 部根据 BOM 清单制定物料采购计划，向采购部发出物料申请单；采购部根据产品性价比、产能及交货周期等要素对供应商进行择优选择，并生成采购订单经审批后发送至供应商；



供应商根据签订的采购订单约定的交货时间、数量及质量标准交货，物料经仓管人员进行数量、型号等初步清点检验无误、品质部进行质量检验合格后正式入库；若任一环节检验不合格则进行退换货处理，供应商需按订单要求重新供应合格物料。

## （2）供应商管理

公司建立了完善的供应商管理体系，管理供应商及采购过程，确保采购材料质优价廉，并足量、及时地供应生产所需物料。

供应商的开发与选择：采购部通过收集公开资料、资质审核、样品检验确认、现场考察和小批量试产等流程，对供应商的产品质量、供货能力、交货及时性、服务能力和价格等因素进行多角度综合考察，建立公司的合格供应商名录。

供应商的动态管理：每年采购部和品质部通过定期与不定期相结合的方式对供应商进行考核，考核不合格的供应商需根据考核结果进行限期整改，限期内不予整改或整改后再次考核为不合格的供应商则取消供货资格。

## 4. 生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户需求情况进行生产调度、管理和控制，在客户购货数量的基础上增加适度比例的通用机型库存进行生产，既可将设备成品存货保持在较低水平，提高资产的周转率，又可灵活应对临时性订单需求。在生产过程中，公司采用 ERP 系统对流程进行统一管理。

公司的产品生产由营销中心、研发中心、PMC 部、采购部、制造中心及品质部等多部门协同完成。营销中心负责与客户沟通并确定产品需求；研发中心进行产品设计并提供设计图纸及物料清单等；PMC 部负责编制生产计划；采购部负责根据物料清单采购物料；制造中心负责生产加工、装配和调试；品质部负责生产过程中和产品制成后的质量检查。

## 5. 销售模式

公司以直销模式为主，即公司直接与客户签署合同，直接将货物交付至客户指定的地点，客户直接与公司进行结算。公司境外销售中存在代理销售模式，即公司与代理商达成协议，代理商自行购进产品，由代理商通过自有渠道向下游客户销售产品。

公司经过多年的发展与沉淀，逐步建立了较高的市场地位和良好的品牌形象，并通过存量客户推荐、公司通过收集渠道信息主动发掘以及基于口碑传播下客户主动联系等多种方式开发客户。同时，公司也通过积极参加国内外行业会议、展会等方式，加强客户开发力度，在深入了解客户内在需求的基础上，营销中心和研发中心为客户协同制定个性化的整套解决方案，进而与客户建立长期良好合作关系。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是一家从事半导体、LED、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售，为客户实现智能制造提供稳定、先进的装备及解决方案的企业。公司作为国内领先的 LED 和半导体固晶机综合解决方案提供商，在电容器老化测试设备方面亦具有领先优势。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化委员会发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”。根据国家统计局 2018 年 11 月颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为新型电子元器件及设备制造，属于新一代信息技术产业的二级子产业，具体为：“1、新一代信息技术产业”中的“1.2、电子核心产业”中的“1.2.1、新型电子元器件及设备制造”中的“3562、半导体器件专用设备制造”，属于战略性新兴产业。

##### （1）半导体行业

半导体行业是现代信息产业的基础和核心产业之一，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。近年来，PC、手机、液晶电视等 3C 电子产品需求不断增加；同时在以云计算、大数据、物联网、新能源及可穿戴设备等为主的新兴应用领域强劲需求的带动下，全球半导体产业恢复增长。根据世界半导体贸易统计协会预测，2024 年半导体行业规模有望回升至 5,760 亿美元，增长 11.8%。中国已成为全球最大的电子产品生产及消费市场，衍生出了巨大的半导体器件需求。

根据《中国制造 2025》对于半导体设备国产化提出了明确要求：在 2020 年之前，90~32nm 工艺设备国产化率达到 50%，实现 90nm 光刻机国产化，封装关键设备国产化率达到 50%。在 2025 年之前，20~14nm 工艺设备国产化率达到 30%，实现浸没式光刻机国产化。未来十年国产化替代浪潮给国内封装设备企业带来巨大的发展空间。

根据 SEMI 研究统计，在半导体前道与后道工序的全生命周期制程中，封装设备约占半导体设备市场规模的 6%，其中焊线机占封装设备市场规模的 32%。

半导体封装环节重点主要是固晶及焊线环节，固晶环节对设备的超高精度、三维定位等提出了极高的要求，而焊线中的引线键合作为封装环节最关键的步骤之一，具有极高的技术壁垒，使用的焊线设备对速度、精度、稳定性有严格要求，核心难点在于控制引线在焊盘的键合质量以及引线在三维空间的线弧轨迹。

##### （2）LED 行业

小间距 LED 显示具有无拼缝、显示效果好、使用寿命长等优势，市场需求稳定，且近年来成本下降较快，形成对 LCD 与 DLP 替代的趋势，其应用范围已从政府的公共信息显示扩展到商业显示。随着 LED 显示屏在租赁市场、HDR 市场应用、零售百货、会议室市场需求增加，Mini/Micro LED 渗透提速，推动 LED 市场迎来结构性改革。根据 TrendForce 集邦咨询预测，2027 年 LED 市场产值

有望成长至 210.13 亿美金，2022-2027 年复合成长率达 8%。

Mini/Micro LED 被看作未来 LED 显示技术的主流和发展趋势，是继 LED 户内外显示屏、LED 小间距之后 LED 显示技术升级的新产品，具有“薄膜化，微小化，阵列化”的优势，将逐步导入产业应用。从终端应用场景来分，Mini LED 的应用领域可以分为直显和背光两大场景。Mini LED 直显多应用在大尺寸显示如室外大屏、指挥中心大屏、墙幕显示等领域，在超高清显示方面优势明显；Mini LED 背光显示是在背光模组中使用 LED 实现分区控光，实现高动态对比度的同时可以避免 OLED 的烧屏问题，具有高分辨率、高色彩对比度、更快反应速度、寿命长和省电等优势。

公司 LED 固晶机设备主要用在封装与模组工艺流程中的固晶环节，固晶环节主要技术难点在于对固晶设备超高精度和超高良率的要求。随着 Mini/Micro LED 显示产品的研发升级，对晶片电流精度和图像显示效果的一致性指标产生了更高要求，进而对固晶设备的技术指标产生了更严格的要求。

### （3）电容器行业

电容器是电子设备中被广泛应用的基础电子元件之一，根据介质不同，可分为铝电解电容器、钽电解电容器、陶瓷电容器和薄膜电容器等。近年来，随着信息技术和电子设备的快速发展及全球制造业向国内转移，电容器需求呈现出整体上升态势，我国已成为世界电容器生产大国和出口大国。

超级电容器又称双电层电容器、电化学电容器，是一种新型储能装置，其具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器作为高效储能器件，广泛应用于国防军工、轨道交通、城市公交、发电与智能电网、消费电子等重要领域，能够有效解决大负荷电路运行的难题，保证电力电子设备使用性能的正常发挥。目前国内超级电容器市场渗透率较低，发展潜力巨大。据 QYResearch 数据，全球超级电容器市场将从 2020 年的 197 亿元增长到 2026 年的 583 亿元，CAGR 为 16.5%，未来渗透率有望提升。

公司电容器设备主要用在铝电解电容器的老化和测试环节，主要技术难点是对电容器设备性能一致性和稳定性方面有严格的要求，对电容器设备的相关参数如容量、漏电、阻抗，测试精度等都有相应的技术要求。

### （4）锂电池行业

锂电池主要应用于手机、笔记本电脑等数码产品以及电动汽车、储能等领域。受益于消费电子产品的广泛使用、新能源汽车的政策支持与推广，将带动锂电池设备市场规模不断扩大，我国已成为全球锂电池最主要的生产国之一。据 S&P Global Market Intelligence 数据显示，中国锂电池产能约占世界产能 77%，是全球最大锂电池制造市场。未来几年，锂电池在动力电池领域和储能领域整体发展趋势积极向好。

公司锂电池设备主要涉及卷绕机、制片机、及制片卷绕一体机等产品，目前国内动力锂电池主要采用卷绕工艺，卷绕机为中段工艺环节核心设备。主要技术难点在于生产过程中，对裁切极

片的整齐度、极片毛刺、极片纠偏、卷绕等方面性能指标有严格的精度要求，对生产效率和软件与结构优化的更新需求频繁。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内 LED 固晶机和电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业，凭借过硬的产品质量、技术创新能力和高效优质的配套服务能力，在持续同步积极开拓半导体及 LED 领域的合作客户。历经多年技术积累和业务发展，公司积累了一大批以国内知名公司及国际知名厂商为核心的优质客户群体，与其建立了长期稳固、携手并进的合作关系，并以此作为枢纽，进一步寻求更多合作伙伴，向世界提供中国方案。

公司在半导体设备领域已具有较强的市场竞争力及较高的品牌知名度，增长潜力巨大，封测业务涵盖 MEMS、模拟、数模混合、分立器件等领域，为包括华为、长电、华天科技、通富微、固得电子、扬杰科技、韶华科技等知名公司在内的庞大优质客户群体提供定制化服务。公司半导体固晶设备近年来获得大批业内优秀企业深度合作，已成为公司业务收入的有力支撑点。公司通过收购开玖自动化，积极研发半导体焊线设备，实现固晶与焊线设备的协同销售，有效扩展公司在半导体封测领域中的产品应用和市场空间，助力公司未来多元化成长。

在 LED 设备领域，公司的客户包括京东方、辰显光电、洲明科技、利晶微、兆驰晶显、高科视像、高科华兴、中麒光电、三安光电、国星光电、鸿利智汇、瑞丰光电、雷曼光电、恒芯达等优秀企业，并与国际知名厂商 SAMSUNG、亿光电子等长期保持良好合作。

公司自设立以来一直深耕电容器老化测试设备领域，凭借领先的技术优势和良好的服务质量，已成为国内知名电容器厂商首选的设备品牌之一，并与艾华集团、江海股份、丰宾电子等业内头部公司建立深入合作。

在锂电池设备领域，公司蓄势待发，积极投入研发，加强技术储备，力求差异化路线突破。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### （1）半导体行业

当前，全球半导体行业景气度下行，但近年来，新能源、AI 人工智能、自动驾驶、VR 显示等新兴领域的发展和需求为半导体行业带来新的发展机遇，在经济发展与行业发展的双驱动下，产生巨大的半导体设备市场空间。在国产替代加速、行业技术升级和国家产业政策扶持等多重利好加持下，国内半导体企业有望迎来黄金发展期，我国半导体产业发展前景明朗。

在后摩尔时代，封装工序的重要性持续增加，半导体封装设备市场规模有望逐步增长，固晶作为半导体封装的重要工序环节，需求将同步增长，2024 年 4 月，SEMI 发布的《全球半导体设

备市场报告》指出，2023 年全球半导体制造设备销售额从 2022 年的 1,076 亿美元的历史记录小幅下降 1.3%，至 1,063 亿美元。2023 年芯片设备支出排名前三的中国内地、韩国和中国台湾占全球设备市场的 72%，中国仍然是全球最大的半导体设备市场。

## （2）LED 行业

全球经济复苏缓慢，工业生产端表现弱势，造成 LED 行业市场需求出现波动，但总体还是市场规模逐步增加。根据 Arizton 预计，全球 Mini LED 市场规模将由 2021 年的 1.5 亿美元增长至 2024 年的 23.2 亿美元，年均复合增长率为 149.2%。

Mini LED 芯片技术路线逐渐成熟，上游芯片厂商加码布局量产。Mini LED 要求 LED 的芯片尺寸在 100 微米以下，且对于芯片发光的均一性等有很高的要求。目前 Mini LED 芯片主要采用倒装结构，可以满足芯片微缩化的同时提升发光效率，提高芯片寿命，Mini LED 芯片生长外延技术逐渐成熟。下游终端客户出货需求拉动，叠加对 Mini LED 应用前景的看好，上游 LED 芯片厂商布局和扩产的意愿较强。

近年来，各大厂商纷纷在 Mini/Micro LED 方面布局，固晶机设备下游应用的显示产品已达千万像素级，Mini/Micro LED 显示产品对晶片电流精度和图像显示效果的一致性指标产生了更高要求，未来固晶机设备将向着超高精度化、软件智能化、设备集成化方向发展，以此降低生产成本，提高生产效率与精度。

## （3）电容器行业

随着市场需求的迅速扩大和国家新能源政策的牵引，超级电容器作为一种新型的储能器件，以其循环寿命长、高功率密度及能量密度、工作温度范围宽等优良特性，应用领域不断拓展，市场规模也在逐步增加。未来随着智能电网、轨道交通、消费电子等下游应用领域对超级电容应用的广泛普及，中国的超级电容器市场将持续保持积极增长态势。

## （4）锂电池行业

受到下游新能源汽车的带动，国内动力锂电池的产量保持高速增长态势，成为增长最为强劲的细分领域。根据国家工信部《2023 年全国锂离子电池行业运行情况》统计，2023 年我国锂电池产业持续呈增长态势，全国锂电池总产量超过 940GWh，同比增长 25%，行业总产值超过 1.4 万亿元。由于锂电池生产过程的工序复杂性、材料特殊性与多元性、工艺参数敏感性与高标准，且伴随着市场对高品质电芯需求的增长，迫使锂电池生产厂商采用大规模高程度的自动化生产模式，智能制造装备已成为锂电池生产流程中的必要装备，带动整个锂电制造设备市场规模的快速扩大。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年 增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	2,613,455,825.77	2,444,807,224.32	2,444,750,222.09	6.90	2,433,355,984.93	2,433,329,082.19
归属于上市公司股东的净资产	1,387,645,059.08	1,370,878,146.77	1,370,821,144.54	1.22	1,249,502,089.14	1,249,475,186.40
营业收入	1,040,169,545.35	1,183,655,880.89	1,183,655,880.89	-12.12	1,196,636,273.34	1,196,636,273.34
归属于上市公司股东的净利润	60,303,832.22	204,744,965.84	204,714,866.35	-70.55	232,035,786.73	232,008,883.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,960,849.74	185,520,379.78	185,490,280.29	-74.15	219,592,680.02	219,565,777.28
经营活动产生的现金流量净额	-960,009.45	-273,063,858.95	-273,063,858.95	不适用	-96,067,500.37	-96,067,500.37
加权平均净资产收益率(%)	4.38	15.56	15.56	减少11.18个百分点	23.53	23.53
基本每股收益(元/股)	0.59	2.01	2.01	-70.65	2.48	2.48
稀释每股收益(元/股)	0.59	2.01	2.01	-70.65	2.48	2.48
研发投入占营业收入的比例(%)	9.28	7.57	7.57	增加1.71个百分点	6.39	6.39

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	358,169,549.70	180,866,611.33	285,487,889.49	215,645,494.83
归属于上市公司股东的净利润	58,331,276.51	-14,232,709.40	12,071,091.75	4,134,173.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	57,019,007.39	-18,062,717.06	9,466,334.23	-461,774.82
经营活动产生的现金流量净额	-51,976,931.98	-1,739,147.94	-14,952,412.47	67,708,482.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股东情况

##### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,425
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,009
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

##### 前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
胡新荣	0	37,631,757	36.85	37,631,757	37,631,757	无	0	境内 自然 人
宋昌宁	0	30,789,619	30.15	30,789,619	30,789,619	无	0	境内 自然 人
深圳市春江投资合伙企业(有限合伙)	0	2,249,999	2.20	2,249,999	2,249,999	无	0	其他
深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,852,734	1.81	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—民生加银持续成长混合型证券投资基金	1,213,276	1,713,276	1.68	0	0	无	0	其他



招商银行股份有限公司—东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,400,144	1,400,144	1.37	0	0	无	0	其他
李国军	-376,800	1,223,200	1.20	0	0	无	0	境内自然人
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	722,091	1,122,182	1.10	0	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司—兴全合润混合型证券投资基金	-19,395	1,053,838	1.03	0	0	无	0	其他
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	811,188	811,188	0.79	0	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东胡新荣、宋昌宁为一致行动人；2、春江投资为公司员工持股平台，其中胡新荣持有其 16.82% 的出资份额并担任普通合伙人、宋昌宁持有其 13.76% 的出资份额为其有限合伙人；3、其他股东未知是否属于关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

**存托凭证持有人情况**

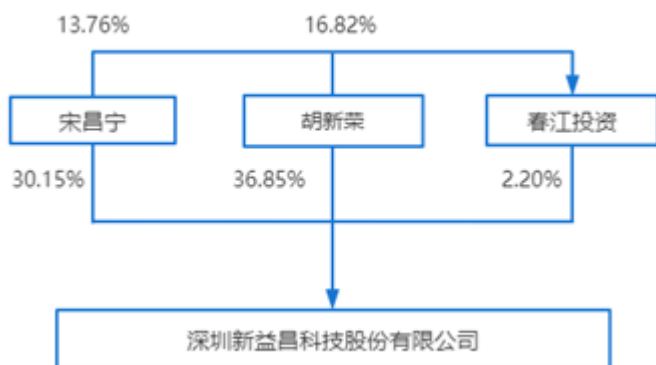
适用 不适用

**截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

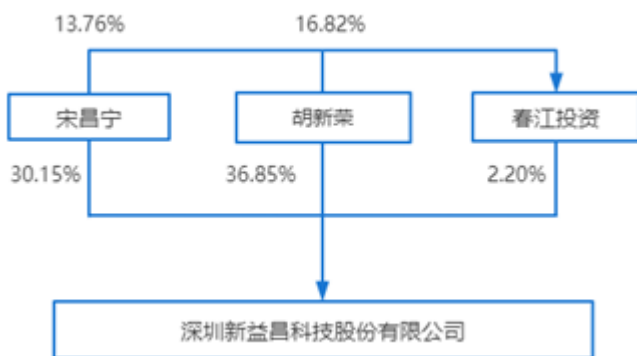
**4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 104,016.95 万元，较上年同期减少 12.12%；归属于上市公司所有者的净利润 6,030.38 万元，较上年同期减少 70.55%；归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4,796.08 万元，较上年同期减少 74.15%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用